

BEST AVAILABLE COPY

20239/0202029-US0

PTO/SB/106 (05-00)

Approved for use through: 10/31/02. OMB 0631-0032  
Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

## Declaration and Power of Attorney for Patent Application

## 特許出願宣言書及び委任状

## Japanese Language Declaration

## 日本語宣言書

私は、以下に記載された発明者として、ここに下記の通り宣言する：

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、郵便の宛先として同様は、私の氏名の後に記載されたものである。

My residence, post office address, and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明について、特許請求範囲に記載され、且つ特許が求められている発明本質に照して、私は、最初、最先且つ唯一の発明者である（唯一の氏名が記載されている場合）か、或いは最初、最先且つ共同発明者である（複数の氏名が記載されている場合）を明記している。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

SUBMOUNT AND SEMICONDUCTOR DEVICE

SUBMOUNT AND SEMICONDUCTOR DEVICE

上記発明の特許権はここに割付されているが、下記の欄がチェックされている場合は、この限りでない：

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

☒ July 30, 2003 の日に提出され、☒ was filed on July 30, 2003

この出願の米国出願番号またはPCT国際出願番号は、

as United States Application Number or

PCT International Application Number

PCT/JP2003/009706 であり、且つ

PCT/JP2003/009706 and was amended on

(if applicable).

の日に修正された図面（該当する場合）

私は、上記の修正によって書き直された、特許請求範囲を含む上記図面を提出し、且つ内容を理解していることをここに表明する。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、特許規則第1.56条（37 CFR 1.56）に定義されている、特許性について重要な情報を開示する義務があることを認める。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.